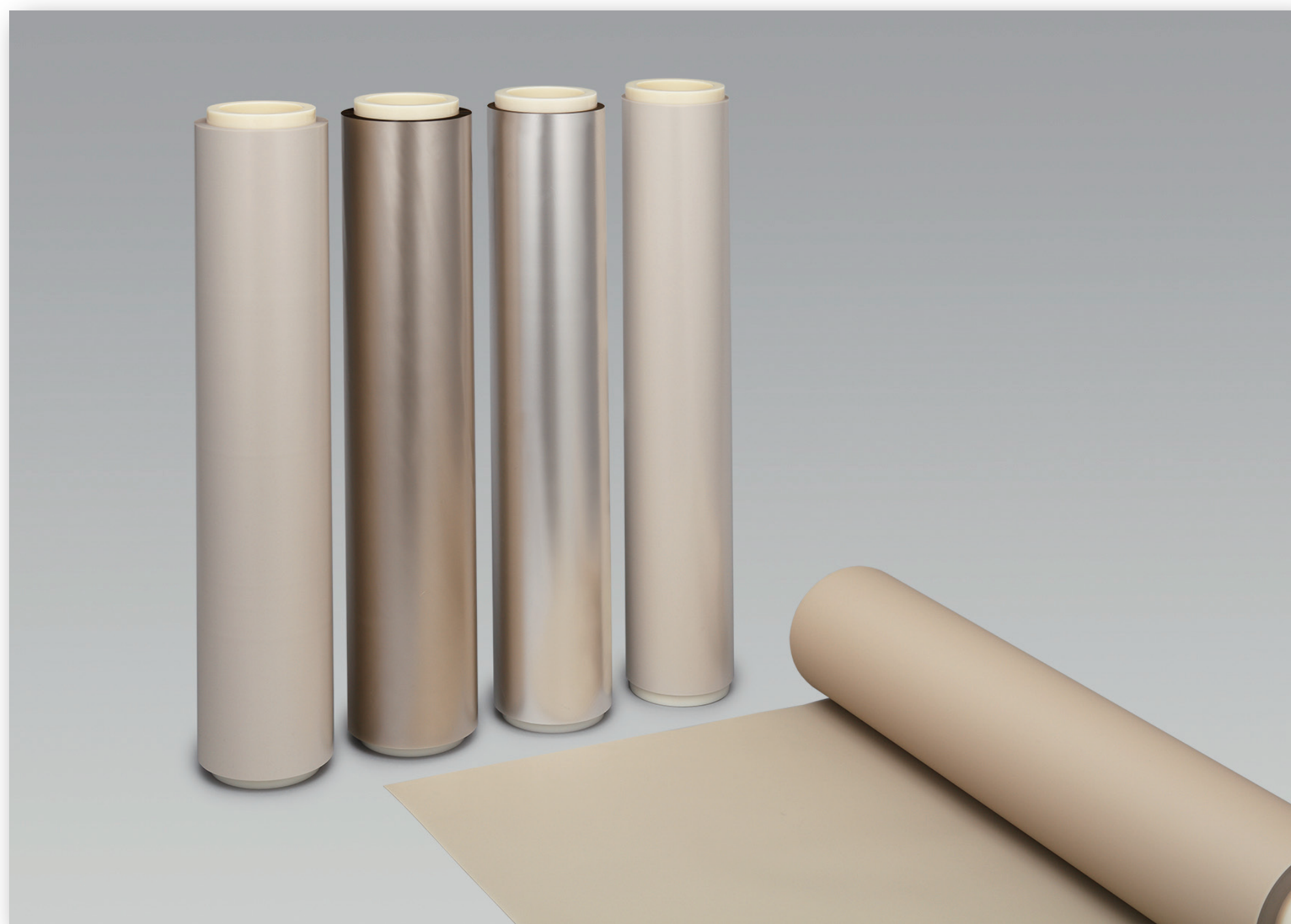


PEEKフィルム

PEEK Film

[Shin-Etsu Sepla Film PEEK]



溶融押出Tダイ製法

- スーパーエンブラであるPEEK樹脂を製膜したフィルム

対応厚み・結晶化度

- 低結晶タイプ / 3 ~ 9 μ m
- 高結晶タイプ / 50 ~ 250 μ m

特 長

- 熱可塑性樹脂フィルム
- 低結晶タイプ / 高結晶タイプ
- 耐熱性 ● 耐薬品性 ● 耐摩耗性 ● 摺動性
- 高弾性 ● 低吸水性 ● 融点337℃ ガラス転移点149℃
- 燃焼しても毒性ガス発生無し

産業分野

情報通信機器・産業インフラ・
医療・航空機・自動車 等

応用展開例

- スピーカー振動膜
- モーター絶縁紙
- 耐熱絶縁基材 ● 断熱袋
- CF RTP基材
- 半導体・FPC製造時の工程内キャリア用途

Shin-Etsu Sepla Filmは、信越化学株式会社の登録商標です。